证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:临2025-114

转债代码:110081　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月23日收到上海证券交易所《关于闻泰科技股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2025】0632号),公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查,现就监管问询函中提及的相关问题回复如下:

1、年报及前期公告显示,2024年末公司货币资金、交易性金融资产账面余额分别为78.34亿元、17.63亿元,合计金额95.97亿元,同比增长30.50%;短期借款、长期借款、应付债券余额合计181.29亿元,当期利息费用6.93亿元。货币资金中,银行承兑汇票保证金等受限货币资金合计16.24亿元,存放于境外款项27.13亿元,同比增长146.41%。2025年4月,公司公告拟终止配合可转债募投项目并将约28.46亿元剩余募集资金永久补流。2025年5月,公司披露重大资产出售报告书(草案),已收到交易对方支付的交易价款合计22.87亿元。

请公司补充披露:(1)货币资金存放地点、类型、主要借款银行、利率水平、资金用途等,结合公司日常营运资金需求、经营现金流等情况,说明公司在保有较多货币资金的同时存在较多有息借款并承担较高利息费用的原因、必要性及合理性;(2)受限货币资金存放的具体银行支行名称及对应金额,结合公司控股股东、实际控制人及其关联方在上述银行的存贷款金额,说明公司是否存在与控股股东及其关联方联合或共管账户的情况,是否存在货币资金被其他方实际使用的情况,是否存在为其他方违规提供担保等潜在的合同安排或潜在的限制性用途;(3)货币资金存放于境外的具体情况,包括资金来源及用途、存放地点及类型、各月末存放金额及占比等,说明2024年内存放于境外款项金额大幅上升的原因及合理性;(4)永久补流资金、交易性金融资产的实际使用情况及后续具体安排,说明相关资金的使用是否有利于提升公司持续经营能力和维护上市公司利益。请年审会计师对问题(1)至(3)发表意见,请独立董事对问题(2)发表意见。

回复:

一、货币资金存放地点、类型,主要借款银行、利率水平、资金用途等,结合公司日常营运资金需求、经营现金流等情况,说明公司在保有较多货币资金的同时存在较多有息借款并承担较高利息费用的原因、必要性及合理性

截至2024年12月31日,货币资金的存放地点及类型如下:

单位:万元

地区/项目	中国大陆	欧洲地区(安世集团)	中国香港	印度	美国	其他	合计	占比
库存现金	10.94	4.52	1.07	0.12	–	0.05	16.70	0.00%
银行存款	351,024.26	123,930.45	82,197.76	32,929.75	25,899.57	5,068.80	621,050.59	79.27%
其中:可随时用于支付的银行存款	351,024.26	123,930.45	82,197.76	32,929.75	25,899.57	5,068.80	621,050.59	79.27%
其他货币资金	161,122.04	–	67.82	1,172.58	–	–	162,362.44	20.72%
其中:承兑保证金	154,954.40	–	–	–	–	–	154,954.40	19.78%
信用证保证金	3,000.00	–	–	–	–	–	3,000.00	0.38%
冻结资金(注1)	2,285.66	–	–	–	–	–	2,285.66	0.29%
其他(注2)	881.97	–	67.82	1,172.58	–	–	2,122.37	0.27%
合计	512,157.24	123,934.97	82,266.65	34,102.45	25,899.57	5,068.85	783,429.73	100.00%
占比	65.37%	15.82%	10.50%	4.35%	3.31%	0.65%	100.00%	

注1:冻结资金包括:(1)冻结资金10.57万元:因江苏科瑞恩科技股份有限公司诉讼案被冻结;(2)冻结资金2,275.09万元:因中建四局第五建筑工程局有限公司诉讼案被冻结;

注2:(1)中国大陆的其他项主要包括:(1)811.71万元的保函保证金、(2)因银行留存的法人信息未及时更更导致6853.72万元资金使用受限(1月已完成变更,目前正常使用)及(3)ETC保证金等;(2)印度阿泰的其他项主要包括专用于向印度海关支付关税及进口增值税的银行账户资金余额9285.52万元及进口保证金987.13万元;(3)香港阿泰的其他项指67.82万元因商证信息过期导致使用受限,3月已在银行维护更新,目前正常使用;

根据公司ODM业务过去三年货币资金使用情况,正常业务经营每月平均付现成本约为39亿元,公司境内货币资金51亿元,扣除约16亿元受限货币资金,剩余可使用的货币资金为35亿元;根据公司半导体业务过去三年货币资金使用情况,正常业务经营每月平均收现1.98亿美元,付现成本约为1.53亿美元,经营现金净收入4,600万美元,大约一半用于支付资本支出,仍可每月盈余现金2,300万美元,2024年底货币资金余额1.18亿美元,无受限货币资金,也无外部借款。综上,公司持有货币资金规模与每月付现成本相匹配。

于2024年末,公司承担的有息负债及本年内相应承担的利息支出如下:

单位:万元

有息负债类型	2023/12/31余额(A)	2024/12/31余额(B)	有息负债占比	本年财务费用-利息支出额(C)	平均利率(C/(A+B)/2))
应付债券(含一年内到期的应付债券)	795,340.89	835,581.65	44.74%	42,846.69	5.25%
银行借款	966,247.77	982,823.69	52.63%	23,407.18	2.40%
其中:商业票据贴现知期借款	546,722.30	896,891.26	48.03%	9,704.48	1.34%
除商业票据贴现外的银行借款(注)	419,525.47	85,932.43	4.60%	13,702.70	5.42%
租赁负债	60,495.61	49,102.24	2.63%	3,011.98	5.50%
合计	1,822,084.27	1,867,507.58	100%	69,265.85	3.75%

注:(1)截至2025年5月底,除商业票据贴现外的银行借款余额约3.7亿元人民币,产品集成业务中,闻泰科技(深圳)有限公司(以下简称“深圳闻泰”)借款余额1.5亿元,借款利率2.3%;黄石智通电子有限公司(曾用名黄石闻泰通讯有限公司,以下简称“黄石闻泰”)借款余额1.7亿元,借款利率2.85%;深圳闻泰和黄石闻泰已于2025年7月2日交割给立讯通讯(上海)有限公司,后续的还款义务也由对方承接;半导体业务中安世半导体(中国)有限公司(以下简称“安世中国”)借款0.5亿元,借款利率2.1%,半导体业务的银行融资主要是为了提升公司资金效率和降低融资成本,安世中国于2024年11月起在将商银行每月开具一年期的电费证结算电费,开证时付0.05%的开证手续费,以付时支付约2%的年化率,一年到期后还本给银行。此举能改善公司现金流,提升公司资金效率。同时还能赚取人民币融资利息低利美金存款利息高的利差。

(2)非商业票据贴现类的银行借款的年平均借款利率约为5.42%,主要是由于境外安世半导体借入的短期质押借款利率较高。安世半导体质押借款在2023年12月31日的余额为297,782.72万元(占2023年12月31日除商业票据贴现外的银行借款余额比例为70.98%),借款利率为SOFR+1.25%(其中,2023年11月SOFR利率水平约5.3%),此借款在2024年10月才进行了偿还,故2024年除商业票据贴现外的银行借款的平均利率较高。

其中,公司的短期借款和长期借款的金额为96.59亿元,1.69亿元,占比分别为98.28%和1.72%,其中短期借款包括商业承兑汇票(9.02亿元,占比9.18%)、银行承兑汇票(63.00亿元,占比64.10%)与国内信用证(17.67亿元,占比17.98%)贴现,合计89.69亿元,占总借款余额的91.26%。

其中,商业票据均为不带息票据,主要是集团内部公司之间开具的商业票据(包括银行承兑汇票、商业承兑汇票与国内信用证),用于内部交易货款的支付。公司商业票据的平均手续费约为1.4%,这一手续费水平低于公司持有货币资金的平均理财收益2.1%。

下半年为公司的销售旺季,公司常于第二及第三季度开始增加相关产品的备货与生产。受经营周期以及年末供应商回款要求的强烈影响,公司于第四季度开始增加商业票据开具以获取经营性资金融资;同时由于公司于2024年12月2日被列入实体清单,考虑A客户要求增加出货量、保障集团业务正常运行及应对事件发展的不确定性,公司利用商业票据进行对外支付以保留更多自有资金以增强公司的流动性和应对突发事件的能力。同时,公司商业票据的综合成本低于公司自有资金的理财收益,公司更多利用商业票据对外支付具有合理性。

综上,基于公司提升流动性,增强应对外部不确定性能力,以及提升资金使用效率和收益角度考虑,公司在保有较多货币资金的同时利用较多商业票据(有息借款)对外支付,具有商业合理性和必要性。

二、受限货币资金存放的具体银行支行名称及对应金额,结合公司控股股东、实际控制人及其关联方在上述银行的存贷款金额,说明公司是否存在与控股股东及其关联方联合或共管账户的情况,是否存在货币资金被其他方实际使用的情况,是否存在为其他方违规提供担保等潜在的合同安排或潜在的限制性用途;

2024年,公司受限货币资金16.24亿元,主要用于开具银行承兑汇票的保证金,与控股股东的存贷业务无关。公司与控股股东的银行业务相互独立,不存在利益关联。

截至2024年12月31日,公司的受限货币资金、控股股东(含关联方)在相关银行的存贷金额列示如下:

单位:亿元

具体存放支行	受限货币资金金额	受限类型	公司控股股东、实际控制人及其关联方在银行的贷款金额	公司控股股东、实际控制人及其关联方在银行的贷款类型
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	2.60	银行承兑汇票保证金及其他	0.01	10.95	抵押借款
中国银行股份有限公司深圳南头支行	1.31	银行承兑汇票保证金	–	4.55	保证借款
中国建设银行股份有限公司深圳凤凰支行	0.99	银行承兑汇票保证金	–	–	不适用
上海浦东发展银行股份有限公司深圳科苑支行	0.94	银行承兑汇票保证金	–	–	不适用
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	0.80	银行承兑汇票保证金及信用证保证金	–	–	不适用
中国银行股份有限公司深圳之园路支行、中国银行股份有限公司昆明市新城支行	0.85	银行承兑汇票保证金及冻结资金	0.01	1.40	抵押借款
交通银行股份有限公司昆明白塔路支行	0.76	银行承兑汇票保证金及冻结资金	–	–	不适用
中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	0.75	银行承兑汇票保证金	–	–	不适用
中国农业银行股份有限公司河北雄安支行	0.64	银行承兑汇票保证金	–	–	不适用
中国民生银行股份有限公司成都兴业支行	1.26	银行承兑汇票保证金	0.00	–	不适用
中国农业银行股份有限公司成都兴南支行	0.50	银行承兑汇票保证金	0.01	–	不适用
中国民生银行股份有限公司成都石支行	0.50	银行承兑汇票保证金	–	–	不适用
上海浦东发展银行无锡中山支行	0.50	银行承兑汇票保证金	–	–	不适用
中国建设银行股份有限公司无锡胡岗支行	0.49	银行承兑汇票保证金	–	–	不适用
中国工商银行股份有限公司成都武侯支行	0.45	银行承兑汇票保证金	–	–	不适用
招商银行股份有限公司上海田林支行	0.3	银行承兑汇票保证金	0.01	–	不适用
中信银行股份有限公司嘉兴分行	0.06	银行承兑汇票保证金	0.24	–	不适用
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	–	其他	0.1	10.24	抵押借款
其他	2.54	银行承兑汇票保证金、冻结资金及其他	–	–	不适用
合计	16.24		0.38	27.13	

公司控股股东、实际控制人及其关联方在上述银行的存款金额合计为0.38亿元人民币,均为其自有资金存款,与公司受限货币资金无关联;贷款金额合计为27.13亿元,贷款用途主要为自身经营周转,公司未以受限货币资金为该等贷款提供担保或其他增信措施。

经核查公司及关联方的银行账户开立及管理情况,公司不存在与控股股东及其关联方联合开立或共管银行账户的情况。公司所有银行账户均由公司独立管理,账户资金的使用严格遵循内部控制基本规范及公司财务管理制度,不存在其他方对公司账户资金使用的控制权或管理权。

公司受限货币资金及其他货币资金均由公司独立支配和使用,不存在被控股股东、实际控制人及其关联方或其他方实际使用的情况。公司建立了完善的资金管理制度,资金收支均基于真实的业务背景,且严格按照法律法规及公司章程执行。

公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方或其他方违规提供担保的情况,亦不存在此类潜在的合同安排或限制性用途。公司对外担保行为均严格按照《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》履行审批程序和信息披露义务。

三、资金存放于境外的具体情况,包括资金来源及用途、存放地点及类型、各月末存放金额及占比等,说明2024年内存放于境外款项金额大幅上升的原因及合理性;

存放于境外的货币资金主要为境外运营实体的货币资金,主要为安世集团、香港阿泰、美国闻泰、印度闻泰等境外主体。2023年12月31日及2024年12月31日,存放于境外的货币资金情况如下:

单位:亿元

公司主体	存放地区	2023/12/31				2024/12/31				变动	资金来源	资金用途
		库存现金	银行存款	其他货币资金	合计	库存现金	银行存款	其他货币资金	合计			
安世集团	欧洲	–	4.37	–	4.37	–	12.39	–	12.39	8.02	经营活动、投资活动	投资活动、筹资活动
香港阿泰	中国香港	–	2.83	–	2.83	–	7.72	0.01	7.73	4.90	经营活动、筹资活动	经营活动
印度阿泰	印度	–	0.96	0.09	1.05	–	3.29	0.12	3.41	2.36	经营活动	经营活动
美国阿泰	美国	–	1.01	–	1.01	–	2.59	–	2.59	1.58	经营活动	经营活动
印尼阿泰	印尼	–	0.85	–	0.85	–	0.47	–	0.47	-0.38	经营活动	经营活动、筹资活动
香港裕成	中国香港	–	0.38	–	0.38	–	0.38	–	0.38	–	经营活动	经营活动
其他	其他	–	0.52	–	0.52	–	0.16	–	0.16	-0.36	经营活动	经营活动
合计		–	10.92	0.09	11.01	–	27.00	0.13	27.13	16.12		

存放于境外的货币资金于2024年内有所增长主要由于以下原因:1.境外子公司安世集团于2024年11月赎回了于交易性金融资产中核算的货币市场基金产品,导致货币资金净额为10.2亿元;2.香港阿泰因2024年迁月为保障集团业务正常运行及应对突发事件,保留更多自有资金,向外部银行借款5.212万美元;3.本年集团销售收入增长,受香港阿泰、印度阿泰、美国阿泰等子公司A客户及T-Mobile销售收入增长影响,回款相应增加导致经营性现金流有所增长。

2024年各月末境外货币资金存放金额及占比如下:

单位:亿元

日期	存放境外	资金余额	存放在境外的占比
2023/12/31	11.01	62.09	17.73%
2024/1/31	8.23	64.49	12.76%
2024/2/29	11.06	70.38	15.71%
2024/3/31	11.86	55.45	21.38%
2024/4/30	17.61	61.93	28.44%
2024/5/31	16.71	60.69	27.53%
2024/6/30	17.59	64.10	27.44%
2024/7/31	18.67	62.00	30.11%
2024/8/31	13.58	68.80	19.74%
2024/9/30	19.94	62.61	31.86%
2024/10/31	18.85	52.47	35.93%
2024/11/30	21.61	56.03	38.56%
2024/12/31	27.13	78.34	34.63%

由上表知,境外货币资金除4月、9月、11月及12月有所变动,其他各月较为平稳。2024年4月增加约5.7亿元,主要为香港阿泰销售收入增长及对应销售回款所致。2024年9月增加6.36亿元主要为香港阿泰对外借款,美国阿泰及印度闻泰销售回款减少所致。2024年11月增加2.76亿元,主要由于安世集团赎回货币市场基金以及香港阿泰等公司向供应商支付货款,理财产品的赎回为整体收益带来了一定增长,但考虑到向供应商支付的货款金额较大,综合影响下期末数据增加2.76亿元。12月增加5.52亿元主要为香港阿泰借入新的借款,且香港阿泰、印度阿泰及美国闻泰销售收入增长,回款导致有所增加。

四、永久补流资金、交易性金融资产的实际使用情况及后续具体安排,说明相关资金的使用是否有利于提升公司持续经营能力和维护上市公司利益。

上市公司自2024年12月被列入实体清单后,对募投项目进行了审慎论证,拟变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金。相关事项已于2025年5月16日提交上市公司2024年年度股东大会,“闻泰转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过。截至2025年5月27日,上市公司已陆续将相关募集资金全部转至公司一般户,转出募集资金合计28.28亿元。相关资金解相较于此前公告披露的2025年3月31日剩余募集资金28.46亿元存在细微差异,其主要是因支付募投项目末期尾款所致,转出后,该款项与其他自有资金共同用于公司生产经营。

公司募投项目终止后,募集资金转永久补流28.28亿元,截至2025年7月2日,公司出售产品集成业务相关资产累计收到交易对手支付的价款15.6亿元,两项合计流动资金约81.88亿元。2025年1-6月,产品集成业务购建长期资产支付4.3亿元,回购二级市场股票支付6亿元,清偿债务约78亿元(含商业票据保证金),其中,清偿商业票据贴现类银行借款77亿元,清偿除商业票据贴现类的银行借款1亿元,目前,公司产品集成业务账面现金约36亿元。后续产品集成业务还需偿还应付供应商款项约20亿元,到期的商业票据贴现类银行借款及信用证借款约13亿元;同时,后续产品集成业务仍有应收货款回款,公司未来将根据经营状况对剩余募集资金用途进行调整。

综上,公司将剩余募集资金用于日常经营所需要的资金量,产品集成业务目前资金面处于适中状态,尚不存在大额闲置资金存放于境外的情形。同时,安世半导体的业务相对独立,就至目前安世半导体的有息负债仅为0.5亿元人民币的暂时性流动借款,资金稳健。

本次重大资产交易完成后,若存在部分富余资金,公司将重点将资金用于半导体领域,特别是半导体业务在国内的研发和供应链的打造,为公司半导体业务的进一步发展、供应链的稳定性打下基础。截至目前,由于本次重大资产出售还在进行,公司目前尚未确定明确具体的投向,待后续明确计划以后,公司将另行披露。

综上,永久补流资金、交易性款后续均将用于上市公司主营业务的日常经营,满足公司半导体核心业务持续稳健发展的资金需求,有利于增强上市公司持续经营能力和抗风险能力,符合公司实际经营情况,亦符合上市公司和股东利益。

五、请年审会计师对问题(1)至(3)发表意见

针对上述事项,会计师执行以下程序:

(1)了解与货币资金、筹资活动相关的内部控制设计的合理性,并实施测试程序证明执行的有效性;

(2)对库存现金执行监盘程序,对银行存款(含期末余额为0的账户、境外银行账户和本期注销的账户)和银行借款执行函证程序,询证函的制作、发函及回函过程均保持独立性,会计师跟进函证的全过程;

(3)获取《银行对账单》、《已开立银行账户清单》及《企业征信报告》,核对与账面余额是否一致,关注有无未披露的抵押、担保等事项,与借款明细表、借款合同、担保合同,检查会计处理是否正确;

(4)检查银行账户发生额,对银行对账单及货币资金序时账进行资金流水的双向核对,并关注是否存在异常流水的情形;

(5)对受限资金执行专项核查,通过银行函证确认受限金额及原因,结合受限原因测算保证金是否按比例支付、涉及到诉讼情况的实时了解诉讼状态等;并核查与受限资金相关的报表披露是否正确;

(6)抽查大额货币资金收支的原始凭证,检查原始凭证是否齐全、记账凭证与原始凭证是否相符,检查货币资金收支的截止是否正确,关注是否存在控股股东占用资金的情况;

(7)对借款利息进行测算并与账面核对,分析利息差异的原因;

(8)检查非记账本位币的折算汇率及折算金额是否正确;

(9)检查货币资金、借款是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当的列报与披露。

经检查,会计师认为:(1)公司持有货币资金规模与每月付现成本匹配,同时为保障集团业务正常运行及应对事件发展的不确定性,公司采用短期借款进行战略性储备资金,故保有较多货币资金的同时存在较多有息借款必要且合理。(2)公司不存在与控股股东及其关联方联合开立或共管银行账户的情况,公司所有银行账户均由公司独立管理,账户资金的使用严格遵循内部控制基本规范及公司财务管理制度,不存在其他方对公司账户资金使用的控制权或管理权;公司受限货币资金及其他货币资金均由公司独立支配和使用,不存在被控股股东、实际控制人及其关联方或其他方实际使用的情况,公司建立了完善的资金管理制度,资金收支均基于真实的业务背景,且严格按照法律法规及公司章程执行;公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方或其他方违规提供担保的情况,亦不存在此类潜在的合同安排或限制性用途。

2、年报及前期公告显示,2024年末公司预付账款3.27亿元,同比增长126.83%,其他非流动资产中预付长期资产款1.42亿元。2024年末其他非流动金融资产4.93亿元,同比增长18.32%,其中非上市公司股权投资4.76亿元,占比达96.55%。

请公司补充披露:(1)预付款项、其他非流动资产中预付长期资产款的主要交易对手方名称及关联关系、交易背景及主要内容、合同签订时点、付款时点、取得相应资产时点,结合商业惯例和必要性说明预付款项大幅增长的原因及合理性;

2024年末,公司预付款项余额32,723.60万元,其中前五大余额23,483.29万元,占比71.76%,相关交易情况如下:

交易对手名称	关联关系	2024期末余额(万元)	交易背景及主要内容	合同签订时点	付款时点	取得相应资产时点	预付比例
CORESYSTEM TECHNOLOGY LIMITED	否	10,693.62	CORESYS-TEM为产品集成业务的芯片原厂MTK指定代理,因实体清单影响原厂要求预付款之后才能发货	2022年11月29日	2024年12月10日至2024年12月26日	截至2025年4月30日已全部收货	100%
Wingskysemi (Hong Kong) Limited(注1)	是	10,281.24	购买晶圆	2023年10月27日	2024年2月1日至2024年6月21日	截至2025年4月30日已收货5,189.97万元	74%
印度海关	否	1,196.33	报关时需预先支付关税	不适用	2024年12月1日至2024年12月31日	不适用,款项性质为税费不涉及资产	100%
CFP Commodities Ltd	否	672.27	2025年热电联产装排放配额		2024年1月1日至2024年12月31日	不适用,款项性质为费用不涉及资产	100%
Willis Towers Watson	否	639.83	保险费		2024年4月15日	2024年8月21日	不适用,款项性质为费用不涉及资产	28%

上述预付款项主要为货款、费用、税金等,大幅增长主要源于CORESYSTEM TECHNOLOGY LIMITED、Wingskysemi (Hong Kong) Limited的货款,属于公司日常经营所需,具有必要性且符合商业惯例,因此预付款项大幅增长具备合理性。

2024年,安世在中国的销售收入呈增长趋势,同时随着半导体行业国际贸易壁垒的加深,为确保未来公司在国内的产品供应安全,公司在2024年着力于培育国内产业链,公司(安世)2024年向鼎泰匠芯投放的晶圆代工订单增长较快。安世的产品具有独特性,属于定制化产品,鼎泰匠芯投产之后不能将半成品挪为他用,因此安世按照行业惯例,下单后向鼎泰匠芯支付了相应的预付款。

由于安世在2024年开始加速培育国内供应链,并逐步将部分台湾晶圆厂的订单转移至鼎泰匠芯。2024年,安世预测鼎泰匠芯在2025年第二季度以后的产能较为紧张,故安世与鼎泰匠芯达成协议以提前生产部分工序的方式开始备货,因鼎泰匠芯启动产能平整会需工序费900万元,安世支付80%的款项,待安世明确出货计划以后由鼎泰匠芯完成全部工序后再支付尾款,这样实现2025年的产品主要工序(80%的工序)在2024年完成,以此方式避免2025年鼎泰匠芯造成产能瓶颈。2024年底,基于该等备货订单累计形成的预付款为10,281.24万元,截至2025年4月30日,安世已经收货并结清预付款5,189.97万元,其余预付款对应的产品,鼎泰匠芯将于2025年生产完成剩下工艺流程,并结清相关预付款。

关于预付,由于晶圆制造是资本、技术密集型业务,晶圆制造企业与上游设计企业需要在技术、工艺、产能规划方面密切配合,并且订单一旦开始执行则晶圆制造企业投入较大,因此行业里经常向晶圆制造企业支付预付款。2021年至2024年,安世均不同金额、不同比例向晶圆制造企业支付预付款,2024年底同期,安世向公司和U公司所支付的预付款/订单金额分别为100%和33%,相比较而言,安世向鼎泰匠芯支付的预付款水平处于居中水平。公司(安世)与鼎泰匠芯之间不存在其他利益安排。

注1:安世与Wingskysemi (Hong Kong) Limited的合同为框架合同,实际交易金额以采购订单为准。根据合同约定,安世将在生产启动前预付后续月份产值的70%,剩余30%依照收货时间支付,收货后支付的账期为60天。

期末其他非流动资产中预付长期资产款金额14,223.47万元,其中前五大金额7,275.27万元,占比51.15%,相关交易情况如下:

交易对手名称	关联关系	2024期末余额(万元)	交易背景及主要内容	合同签订时点	合同金额(万元)	预付比例	付款时点	取得相应资产时点	到货情况
M公司	否	3,277.91	见注1	2022年11月12日	3,277.91	100%	2022年2月7日	见注1	见注1
深圳汇业国际控股有限公司	否	1,551.84	购买贴片机	2024年6月6日	1,724.26	90%	2024年6月20日至2024年8月8日	2025年5月21日	均已到货
深圳市鑫中岩工业设备有限公司	否	1,030.00	购买设备	2023年9月15日	2,060.00	50%	2023年10月25日至2024年2月29日	2024年11月1日、2024年12月28日	均已到货
深圳市恺恩顿精密机械有限公司	否	933.12	购买切割机、钻花机等设备	2024年5月9日、2024年7月30日、2024年5月15日	1,036.80	90%	2024年6月20日	2023年9月22日至2023年9月25日	部分到货:与之发生交易的子公司中,惠兴永晟的股权已于2025年1月26日交割,交割前779.32万元尚未收货
江苏杰士德精密工业有限公司	否	482.40	购买设备	2023年3月27日、2023年4月26日	536.00	90%	2024年8月2日	2023年9月22日至2023年9月25日	均已到货:合同未约定预付条款,设备到货后展开持续调试,在调试后期,设备已投入使用,部分请款,由于未到最终结算时点,相关款项以预付性质入账。

注1:安世向M公司购买产能,并承诺每月最低装载量。为此,安世于2022年2月7日支付了456万美元保证金。该协议有效期至2025年底,故2024年底仍有余额。安世每月交易量达最低装载量,将自2026年1月起可以抵扣应付款项。

二、其他非流动金融资产中非上市公司股权的具体构成,包括但不限于投资主体的名称及股权关系、底层投资标的具体内容、是否涉及关联方等,结合自投资以来的资产经营情况、价值变化情况,说明相关投资的商业合理性;

2024年末,公司其他非流动金融资产中非上市公司股权的具体构成如下:

单位:万元

投资主体名称	投资主体股权关系	被投资公司名称	2024年12月31日期末余额	累计确认公允价值变动收益	底层投资标的具体内容	是否涉及关联方
上海中网金泰半导体有限公司	全资子公司	杭州九州碎创股权投资合伙(有限合伙)	5,000.00		包括杭州易现先进科技有限公司、杭州登虹科技有限公司、成都视海芯图微电子有限公司、天津山河光电科技有限公司、温庆彬博光电股份有限公司、宁波匠心快速成型技术有限公司等29个已投资尚未退出项目	否
上海中网金泰半导体有限公司	全资子公司	上海闻芯企业管理合伙企业(有限合伙)	21,055.13	3,514.06	包括上海麟明电子科技股份有限公司等12个已投资尚未退出项目	是(注1)
上海中网金泰半导体有限公司	全资子公司	无锡启航创业投资(太原)合伙企业(有限合伙)	1,023.34		包含北京诺再科技有限公司、深圳众冠科技有限公司、北京晶飞半导体科技有限公司、图维生物医药科技(苏州)有限公司、清林创能(上海)技术有限公司、物聚星科(北京)科技有限公司、深圳市创飞芯源半导体有限公司、清软微视(杭州)科技有限公司、创博微电子(南京)有限公司、新松威(深圳)科技有限公司、北京麦咖智能科技有限公司、佛山沁芯科技有限公司等52个已投资尚未退出项目	否
上海中网金泰半导体有限公司	全资子公司	上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00		包括上海兴感半导体有限公司、上海芯石科技有限公司、安徽瑞迪微电子有限公司、芯合电子(上海)有限公司、共模半导体(苏州)有限公司等17个已投资尚未退出项目	否
上海闻融企业管理合伙企业(有限合伙)	控股子公司(持股96%)	广东微容电子科技有限公司	9,574.71	4,594.71	广东微容电子科技有限公司	否
NexperiaB.V.	全资子公司	Amadeus APEX Technology EuVECA GmbH & Co KG	976.08	-11.83	人工智能和机器学习、量子技术/光子学、移动性与空间创新、自主系统与机器人技术、以及其他新兴科技领域(如新型材料)	否
NexperiaB.V.	全资子公司	安世(安徽)集成电路有限公司	976.08		人工智能和机器学习、量子技术/光子学、移动性与空间创新、自主系统与机器人技术、以及其他新兴科技领域(如新型材料)	否

注1:公司控股股东闻天下科技集团有限公司作为上海闻芯企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人认缴出资额134,990万元,占全体合伙人认缴出资总额的87.04%,公司作为有限合伙人认缴出资额20,000万元,占全体合伙人认缴出资总额的12.90%,故上海闻芯构成公司的关联方。上海闻芯的普通合伙人为拉萨中创宁信投资咨询有限公司,认缴出资额为100万元,占比0.06%。上海闻芯企业管理合伙企业(有限合伙)撤付期限为2030年12月31日,截至2024年12月闻天下科技集团有限公司对上海闻芯实缴出资额21,001.00万元,占比53.17%,上海中网金泰半导体有限公司对上海闻芯实缴出资18,500.00万元,实缴比例46.83%,均在认缴额度内。鉴于各方缴付节奏不同,期间收益分配按照上海闻芯《合伙协议》约定的“本合伙企业的利润分配和亏损承担应按照各合伙人实缴出资额的比例予以确定”,其底层投资标的不存在产权的关联方。

注2:由于通过合伙企业投资的底层标的数量较多,仅列示底层标的前五大投资金额合计数量与投资比例在内的部分。

自投资以来各底层标的经营情况良好,公司累计确认公允价值变动收益8,096.94万元,底层标的行业范围与公司主营业务相关,故投资具有商业合理性。

三、结合前述问题,说明所涉相关款项是否最终流向公司控股股东及其关联方,是否存在向关联方利益倾斜等情形。请年审会计师、独立董事发表意见。

回复:

一、预付款项、其他非流动资产中预付长期资产款的主要交易对手方名称及关联关系、交易背景及主要内容、合同签订时点、付款时点、取得相应资产时点,结合商业惯例和必要性说明预付款项大幅增长的原因及合理性;

2024年末,公司预付款项余额32,723.60万元,其中前五大余额23,483.29万元,占比71.76%,相关交易情况如下:

交易对手名称	关联关系	2024期末余额(万元)	交易背景及主要内容	合同签订时点	付款时点	取得相应资产时点	预付比例
CORESYSTEM TECHNOLOGY LIMITED	否	10,693.62	CORESYS-TEM为产品集成业务的芯片原厂MTK指定代理,因实体清单影响原厂要求预付款之后才能发货	2022年11月29日	2024年12月10日至2024年12月26日	截至2025年4月30日已全部收货	100%
Wingskysemi (Hong Kong) Limited(注1)	是	10,281.24	购买晶圆	2023年10月27日	2024年2月1日至2024年6月21日	截至2025年4月30日已收货5,189.97万元	74%
印度海关	否	1,196.33	报关时需预先支付关税	不适用	2024年12月1日至2024年12月31日	不适用,款项性质为税费不涉及资产	100%
CFP Commodities Ltd	否	672.27	2025年热电联产装排放配额		2024年1月1日至2024年12月31日	不适用,款项性质为费用不涉及资产	100%
Willis Towers Watson	否	639.83	保险费		2024年4月15日	2024年8月21日	不适用,款项性质为费用不涉及资产	28%

上述预付款项主要为货款、费用、税金等,大幅增长主要源于CORESYSTEM TECHNOLOGY LIMITED、Wingskysemi (Hong Kong) Limited的货款,属于公司日常经营所需,具有必要性且符合商业惯例,因此预付款项大幅增长具备合理性。

2024年,安世在中国的销售收入呈增长趋势,同时随着半导体行业国际贸易壁垒的加深,为确保未来公司在国内的产品供应安全,公司在2024年着力于培育国内产业链,公司(安世)2024年向鼎泰匠芯投放的晶圆代工订单增长较快。安世的产品具有独特性,属于定制化产品,鼎泰匠芯投产之后不能将半成品挪为他用,因此安世按照行业惯例,下单后向鼎泰匠芯支付了相应的预付款。

由于安世在2024年开始加速培育国内供应链,并逐步将部分台湾晶圆厂的订单转移至鼎泰匠芯。2024年,安世预测鼎泰匠芯在2025年第二季度以后的产能较为紧张,故安世与鼎泰匠芯达成协议以提前生产部分工序的方式开始备货,因鼎泰匠芯启动产能平整会需工序费900万元,安世支付80%的款项,待安世明确出货计划以后由鼎泰匠芯完成全部工序后再支付尾款,这样实现2025年的产品主要工序(80%的工序)在2024年完成,以此方式避免2025年鼎泰匠芯造成产能瓶颈。2024年底,基于该等备货订单累计形成的预付款为10,281.24万元,截至2025年4月30日,安世已经收货并结清预付款5,189.97万元,其余预付款对应的产品,鼎泰匠芯将于2025年生产完成剩下工艺流程,并结清相关预付款。

关于预付,由于晶圆制造是资本、技术密集型业务,晶圆制造企业与上游设计企业需要在技术、工艺、产能规划方面密切配合,并且订单一旦开始执行则晶圆制造企业投入较大,因此行业里经常向晶圆制造企业支付预付款。2021年至2024年,安世均不